

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges
Eigentum

Internationales Büro

(43) Internationales
Veröffentlichungsdatum
25. Juni 2015 (25.06.2015)



(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2015/091272 A1

(51) Internationale Patentklassifikation:

B23K 35/26 (2006.01) **B23K 35/02** (2006.01)
B23K 35/36 (2006.01) **H05K 3/34** (2006.01)

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2014/077586

(22) Internationales Anmeldedatum:
12. Dezember 2014 (12.12.2014)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:
13197694.6 17. Dezember 2013 (17.12.2013) EP

(71) Anmelder: **HERAEUS DEUTSCHLAND GMBH & CO. KG** [DE/DE]; Herausstr. 12-14, 63450 Hanau (DE).

(72) Erfinder: **NACHREINER, Jens**; Am Reitacker 17A, 36381 Schlichtern (DE). **WIESE, Joachim**; In den Schafhecken 14, 64739 Höchst/Odw. (DE). **FRITZSCHE, Sebastian**; Salisweg 30B, 63454 Hanau (DE).

(74) Anwalt: **HERAEUS HOLDING GMBH**; Intellectual Property, Herausstr. 12-14, 63450 Hanau (DE).

(81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL,

AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JP, KE, KG, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

(84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), europäisches (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Veröffentlicht:

— mit internationalem Recherchenbericht (Artikel 21 Absatz 3)

(54) Title: SOLDERING PASTE COMPRISING ADIPIC ACID, OXALIC ACID AND AN AMINE COMPONENT

(54) Bezeichnung : LOTPASTE MIT ADIPINSÄURE, OXALSÄURE UND AMINKOMPONENTE

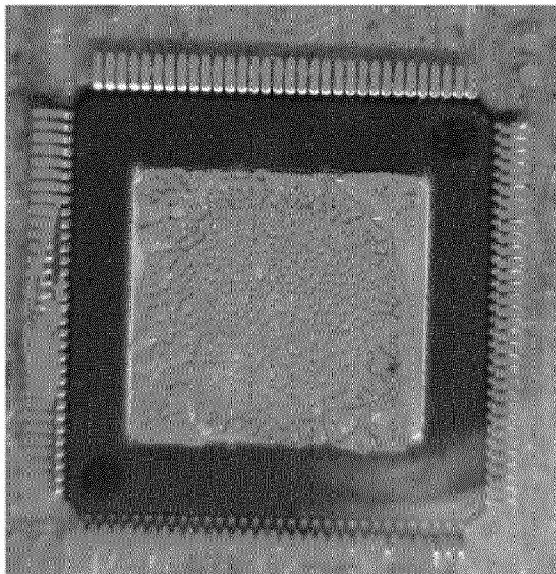


Fig. 2

(57) Abstract: The invention relates to a soldering paste for bonding electronic parts to substrates, said soldering paste containing a mixture of oxalic acid, adipic acid and an amine component, as well as to a method for producing said soldering paste. The invention further relates to a method for bonding an electronic part to a substrate using the soldering paste of the invention as well as to a module comprising the soldering paste of the invention.

(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft eine Lotpaste für das Befestigen von elektronischen Bauteilen auf Substraten, die eine Mischung aus Oxalsäure, Adipinsäure und einer Aminkomponente enthält, sowie ein Verfahren zur Herstellung derselben. Weiterhin betrifft die vorliegende Erfindung ein Verfahren zur Befestigung eines elektronischen Bauteils auf einem Substrat unter Verwendung der erfindungsgemäßen Lotpaste sowie ein Modul, das die erfindungsgemäße Lotpaste umfasst.